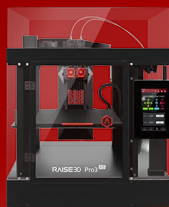


MEX/FFF方式 (材料押出方式)3Dプリンター Raise3D Pro3 Plus HS 取扱説明会

使用可能な樹脂量を拡張し
より高さを活かしやすい大型機種



Raise3D Pro3 HS



Raise3D Pro3 Plus HS

RICOH
imagine. change.

日程

開催日

6月5日(木)
13:30~16:00

場所

オンライン Teams
オンサイト 医学部RI棟2階
セミナー室

講師

日本3Dプリンター株式会社
技術部 花岡 透

<Pro3 HS SERIES> Pro3シリーズをブラッシュアップ、信頼の高性能3Dプリンター

Pro3シリーズを磨き上げ、機能を追加して誕生した最新機種。
モーターなどの各部品をアップグレードし、静音化とより精密な制御を実現しました。
300mm毎秒の高速造形/強化樹脂にも対応。

Raise3D Pro3 Plus HSの概要

導入いたしました3Dプリンター (Raise3D Pro3 plus HS) の
機器本体における基本的な商品概要をご説明いたします。

造形可能な材料の紹介と造形事例

本プリンターにて対応可能な材料 (フィラメント) の特徴と種類の説明、
造形サンプル・事例を加えてご紹介いたします。

造形におけるアプリケーション (ideaMaker) の内容説明

造形前に、サポート条件、造形条件等を指示設定するスライサーソフトの操作説明や
機能説明をデモを交えて細かくご説明いたします。

申込フォーム
6月2日締切



問い合わせ

総合分析実験センター
機器分析部門

問い合わせフォーム
<https://forms.office.com/r/HzLmwuGYrc>



リコージャパン株式会社 佐賀支社
〒849-0912
佐賀市兵庫町瓦町四本松1082
連絡先: 0952-24-0261